

中微半导体设备（上海）股份有限公司

2025 年年度业绩预告的自愿性披露公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

- 中微半导体设备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）预计 2025 年营业收入约 123.85 亿元，较 2024 年增加约 33.19 亿元，同比增长约 36.62%。
- 根据市场需求，公司加大研发力度，新产品数量快速增加。2025 年全年公司研发投入约 37.36 亿元，较 2024 年增长 12.83 亿元（增长约 52.32%），研发投入占公司营业收入比例约为 30.16%。
- 公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 20.80 亿元至 21.80 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4.64 亿元至 5.64 亿元，同比增长约 28.74% 至 34.93%。
- 公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 15.00 亿元至 16.00 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1.12 亿元至 2.12 亿元，同比增加约 8.06% 至 15.26%。
- 公司针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件的超高深宽比刻蚀工艺实现了稳定可靠的大规模量产。其中 CCP 方面，公司用于关键刻蚀工艺的单反应台介质刻蚀产品保持高速增长，能够全面覆盖存储器刻蚀应用中各类超高深宽比需求；ICP 方面，适用于下一代逻辑和存储客户用 ICP 刻蚀设备和化学气相刻蚀设备开发取得了良好进展，加工的精度和重复性已达到单原子水平。到 2025 年底，刻蚀设备反应台全球累计出货超过 6,800 台。公司的 CDP 产品部门为先进存储器件和逻辑器件开发的 LPCVD, ALD 等十多款导体和介质薄膜设备

已经顺利进入市场，并且设备性能完全达到国际领先水平，薄膜设备的覆盖率不断增加。公司 EPI 设备研发团队已经开发出具有自主知识产权及创新的平台，目前减压 EPI 设备已付运成熟制程客户进行量产验证，该种设备同时也付运至先进制程客户进行验证，部分先进工艺已进入量产验证阶段；新一代高选择比预清洁腔体满足先进工艺的需求，已在客户端进行量产验证；常压外延设备现已完成开发，进入工艺验证阶段。在泛半导体设备领域，公司正在开发更多化合物半导体外延设备，已陆续付运至客户端进行验证。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

（二）业绩预告情况

1. 经财务部门初步测算，公司预计 2025 年营业收入约 123.85 亿元，较 2024 年增加约 33.19 亿元，同比增长约 36.62%。其中，2025 年刻蚀设备销售约 98.32 亿元，同比增长约 35.12%；LPCVD 和 ALD 等半导体薄膜设备收入 5.06 亿元，同比增长约 224.23%。

2. 经财务部门初步测算，公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 20.80 亿元至 21.80 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 4.64 亿元至 5.64 亿元，同比增长约 28.74% 至 34.93%。

3. 经财务部门初步测算，公司预计 2025 年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 15.00 亿元至 16.00 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，将增加 1.12 亿元至 2.12 亿元，同比增加约 8.06% 至 15.26%。

（三）本次业绩预告未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

（一）利润总额：170,893.47 万元。归属于母公司所有者的净利润：161,567.57 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：138,815.34 万元。

（二）每股收益：2.61 元。

三、本期业绩变化的主要原因

公司 2025 年度业绩预计较上年同期增长的主要原因如下：

1. 公司主营产品等离子体刻蚀设备作为半导体前道核心设备之一，市场空间广阔，技术壁垒较高。公司的等离子体刻蚀设备在国内外持续获得更多客户的认可，针对先进逻辑和存储器件制造中关键刻蚀工艺的高端产品新增付运量显著提升，先进逻辑器件中段关键刻蚀工艺和先进存储器件超高深宽比刻蚀工艺实现量产。

公司在新产品开发方面取得了显著成效，近两年新开发出十多种导体和介质薄膜设备，目前已有多款新型设备产品进入市场，其中部分设备已获得重复性订单，LPCVD 设备累计出货量突破三百个反应台，其他多个关键薄膜沉积设备研发项目正在顺利推进；公司 EPI 设备已顺利进入客户端量产验证阶段。

公司继续保持国际氮化镓基 MOCVD 设备市场领先地位，积极布局用于碳化硅和氮化镓基功率器件应用的市场，并在 Micro-LED 和其他显示领域的专用 MOCVD 设备开发上取得了良好进展，几款 MOCVD 新产品进入客户端验证阶段。公司新型八寸碳化硅外延设备、新型红黄光 LED 应用的设备已付运至国内领先客户开展验证，目前进展顺利。

公司在南昌约 14 万平方米的生产和研发基地、上海临港的约 18 万平方米的生产和研发基地已经投入使用，保障了公司销售快速增长。公司持续开发关键零部件供应商，推动供应链稳定、安全，设备交付率保持在较高水准，设备的及时交付也为公司销售增长提供有力支撑。公司特别重视核心技术的创新，始终强调创新和差异化并保持高强度的研发投入，同时公司运营管理持续提升，对产品成本及运营费用的控制能力有效增强。

2. 归母净利润同比增加 4.64 亿元至 5.64 亿元（增加约 28.74%至 34.93%）的主要原因：（1）2025 年营业收入增长 36.62%下，毛利较去年增长约 11.45 亿元。（2）由于市场对中微开发多种新设备的需求急剧增长，2025 年公司显著加大研发力度，以尽快弥补国产半导体设备短板，积极赶超，为长期持续增长打好基础。2025 年公司研发投入约 37.36 亿元，较去年增长 12.83 亿元（增长约 52.32%），

2025 年研发投入占公司营业收入比例约为 30.16%，远高于科创板上市公司均值。2025 年研发费用约 24.72 亿元，较去年增长约 10.54 亿元（增长约 74.36%）。(3) 由于二级市场股价波动以及公司出售了部分持有的上市公司股票，经评估师初步评估，公司 2025 年计入非经常性损益的股权投资收益为 6.11 亿元，较上年同期的股权投资收益的 1.98 亿元增加约 4.13 亿元。

3. 扣非后归母净利润同比增加 1.12 亿元至 2.12 亿元（增加约 8.06% 至 15.26%）的主要原因：主要由于 2025 年营业收入增长 36.62%，毛利较去年增长约 11.45 亿元，以及 2025 年研发费用较去年增长约 10.54 亿元。

四、风险提示

本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的经审计后的 2025 年年报为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会

2026 年 1 月 24 日